



IPC-7711C/7721C-AM1 DE

If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence.

Im Falle eines Konfliktes zwischen der englischsprachigen und einer übersetzten Version dieses Dokumentes hat die englischsprachige Version den Vorrang.

Nacharbeit, Änderung und Reparatur von elektronischen Baugruppen

Ergänzung 1

Entwickelt vom Repairability Subcommittee (7-34) des Product Assurance Committee (7-30) des IPC

Übersetzt durch:

Tech.TransLat Roman Meier, www.techtranslat.de

Die Anwender dieser Richtlinie sind aufgefordert, an der Entwicklung künftiger Versionen mitzuarbeiten.

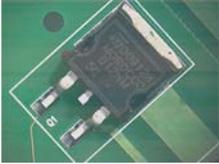
Kontakt:

IPC

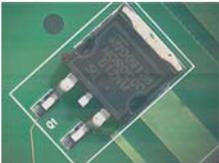
Inhaltsverzeichnis

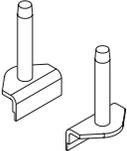
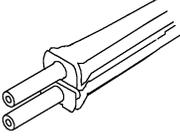
TEIL 2 Nacharbeit

3.1.2 D-Pak-Entfernung

Verfahren	Beschreibung		Leiterplattentyp	Fertigkeiten	Konformitätsgrad
3.1.2	Flussmittel – Pinzetten-Methode		R, F, W, C	Fortgeschritten	Hoch

5.9 D-Pak-Montage

Verfahren	Beschreibung		Leiterplattentyp	Fertigkeiten	Konformitätsgrad
5.9	Flussmittel – Punkt-zu-Punkt-Methode		R, F, W, C	Fortgeschritten	Hoch

 7711 Nacharbeit	Revision: C Ergänzung 1 Datum: 7/20 D-Pak-Entfernung Pinzettenmethode	Nummer: 3.1.2		
		Leiterplattentyp: R, F, W, C Siehe 1.4.2 Fertigkeiten: Fortgeschritten Siehe 1.4.3 Konformitätsgrad: Hoch Siehe 1.5.1		

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Abschnitte 1.7 (Grundüberlegungen), 1.8 (Arbeitsstationen, Werkzeug, Material und Prozesse) und 1.9 (Bleifreie Legierungen) enthalten wichtige Hinweise zur Arbeit mit diesem Verfahren, einschließlich u. a. mit Zinn-Blei- und bleifreien Legierungen. Dieses Verfahren gilt auch für bleifreie Produkte.

BENÖTIGTE GERÄTE

Lötstation
 Pinzettenhandstück
 Entnahmespitzen

MATERIAL

Lot mit Flussmittelseele
 Flussmittel
 Reiniger

VERFAHREN

1. Entfernen von Schutzbeschichtungen (wenn vorhanden) und Beseitigen von Verunreinigungen, Oxid und Rückständen von der betreffenden Fläche.
2. Entlötspitzen in Pinzettenhandstück einsetzen.
3. Begonnen wird mit einer Temperatur der Spitze von ca. 315 °C [599 °F]. Temperatur falls notwendig anpassen.
4. Flussmittel auf die wärmeableitende Anschlussfläche und die Bauteilanschlüsse auftragen. (Siehe Bild 1).
5. Spitze reinigen. Siehe Verfahren 2.8.
6. Unterseite und Innenkanten der Pinzettenspitzen mit Lot verzinnen. (Siehe Bild 2).
7. Lötspitze über das Bauteil absenken und Handstück zusammendrücken, sodass die Bauteilanschlüsse mit den Spitzen berührt werden. (Siehe Bild 3).
8. Vollständiges Aufschmelzen des Lots an ALLEN Verbindungen kontrollieren und Bauteil von der Leiterplatte abheben. (Siehe Bild 4).
9. Bauteil durch Streichen über eine wärmebeständige Oberfläche von den Spitzen lösen.
10. Lötspitzen erneut verzinnen und Handstück in Ablageständer ablegen.
11. Anschlussflächen für den Bauteilwechsel vorbereiten. (Siehe Bild 5).
12. Falls gefordert, reinigen und inspizieren.

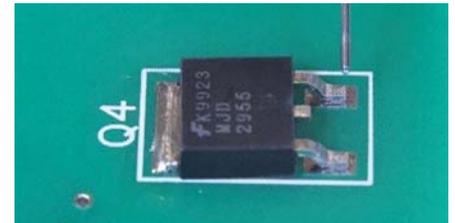


Bild 1 Flussmittel auftragen



Bild 2 Lötspitzen verzinnen

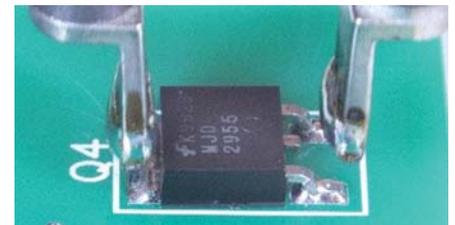


Bild 3 Lötspitzen über das Bauteil absenken und Handstück zusammendrücken

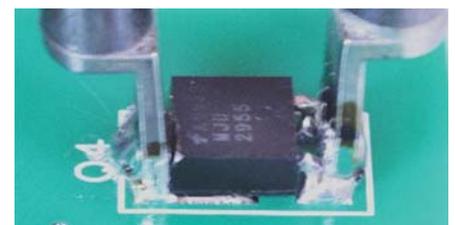


Bild 4 Aufschmelzen des Lots kontrollieren und Bauteil abheben

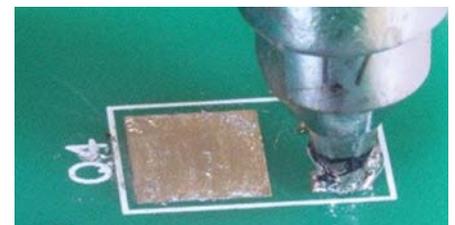


Bild 5 Anschlussflächen für den Bauteilwechsel vorbereiten.